

오공본드 무독이

오공 본드 무독이는 연재 및 경재에 사용하는 다용도의 합성 수지 에멀젼 목재 접착제이며 Setting Time이 빠르고 강한 접착력을 나타내며, 가소제를 첨가하지 않는 제품입니다.

● 특 징

- ① 가소제를 첨가 하지 않는 제품입니다.
- ② 경화가 빠릅니다.
- ③ 톱 등 절단에 사용하는 기구에 손상이 없습니다.
- ④ 목재의 오염이 없습니다.
- ⑤ Glue Spreading machine에의 작업성이 우수합니다.
- ⑥ 초기 접착력이 우수합니다.
- ⑦ 냉압 및 열압에 사용이 용이합니다.

● 사용용도

- ① 연재 및 반경재의 목재, 파티클보드, 하드보드, MDF 등의 접착
- ② 연재 및 경재의 목재 집성재, 무늬목 등의 접착
- ③ 각종 심재의 접착
- ④ 모양지, 각종 벽지, 후로링 등의 건축재 접착
- ⑤ 가구, 건재 등의 Assembly 등의 접착
- ⑥ 시멘트 강도 보강용
- ⑦ 수성 페인트용
- 8 Bond tile 중도용
- ⑨ 건축 단열재용

● 물 성

① 외 관 : 유백색 점조액

② 점 : 16,000 ~ 18,000 CPS/25℃ (RION VT-04F)

③ 고 형 분 : 50 ~ 54%

④ 주 성 분 : 초산 비닐 수지

⑤ p H : 4 ~ 5

⑥ 최저피막온도 : 4℃

⑦ 접 착 력 (kg/cm²) : 상태접착력 : 180이상

내수접착력 : 80이상

● 표준작업사항

① 목재 작업장 및 접착제 표준 온도 : 15 ~ 25℃

② 목재 작업장 및 접착제 최저온도(겨울): 4℃

 ③ 목재의 습도
 : 8 ~ 12%

 ④ 작업장의 상대 습도
 : 65 ~ 75%

⑤ 도 포 량 : 140 ~ 180g/㎡ ⑥ 적 재 시 간 (Assembly Time) : 10 ~ 15분

① 압축시간 : 1시간 ~ 2시간

8 압 력 : 1 ~ 10kg/cm²

● 사용방법

- ① 접착면의 먼지, 물기 및 기타 이물질을 완전히 제거하십시오.
- ② 도포하기 전 내용물을 잘 혼합하여 주시고 사용 중에도 피막이 발생하지 않도록 주의하십시오.
- ③ 용도에 따라 원액 또는 물로 희석하여 사용하되 과도한 희석은 접착불량 및 물성 저하의 원인이 됩니다.

④ 작업에 사용한 도구는 마르기 전에 수돗물로 세척한 후 보관하여야 재사용이 가능합니다.

● 주 의 사 항

- ① 적재 시간과 Setting Time은 작업조건(온도, 목재수분, 상대 습도, 목재의 함수율, 도포량 등)에 따라 달라질 수 있으므로 유의 하십시오.
- ② 압착시 열(30 ~ 40℃)을 가하면 Setting Time이 빨라집니다.
- ③ 피착제면이 평활하지 못하면 접착제의 도포량이 일정하지 않고, 프레스시 밀착이 안되므로 접착 불량의 요인이 됩니다.
- ④ 압착 시간은 작업조건에 따라 정확히 시간을 측정하여 조절하십시오.
- ⑤ 해압을 한 후, 다음 공정에 사용하기 전에 필요한 강도가 얻어질 때까지는 방치하여 두십시오.
- ⑥ 오공 본드 무독이는 비오염성 타입입니다. 그러나 산화철 등이 접촉하면 목재의 탄닌산 (Tannic acid)과 반응하여 접착제의 막이 회색으로 되므로 유의 하십시오.

● 경 고 사 항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시고 내용물의 섭취 및 장시간 피부 접촉 시 두통, 현기증, 피부염 등 건강 장해를 일으킬 수 있으니 주의하십시오.
- ② 유아, 아동용용구, 식품 용기 등에는 사용을 금합니다.
- ③ 작업 시 신체와의 접촉을 방지하기 위해 적절한 보호구를 착용하시고 작업장은 환기를 시켜 주십시오.
- ④ 장시간 피부 접촉 시 물로 충분히 세척하시고 이상 발생시 의사의 조치를 받으십시오.
- ⑤ 물과 접촉하는 곳에는 절대 시공을 피하십시오.
- ⑥ 접착 이외의 용도로는 사용하지 마십시오.

※이상의 자료는 폐사의 연구실에서 오랜 경험과 시험에 의해 얻어진 데이터이나 사용하는 조건에 따라 달라질 수 있으므로 단지 참조하여 주시고 더 자세한 데이터가 필요할 때에는 폐사 부설연구소 및 품질관리팀으로 연락을 바랍니다.